

Quality is more than a word

ESPEC

COMNEXT

次世代通信技術&ソリューション展

次世代通信機器・デバイスの開発において、デバイスの発熱量増加を踏まえた信頼性試験や幅広い温度環境下での動作試験の実施が求められます。

エスペックでは、通信機器・デバイスの開発や設計、製造に役立つ多種多様な試験装置をご紹介します。

出展予定製品

会期 2024年6月26日(水)～28日(金)
10:00～18:00 (最終日は17:00終了)

会場 東京ビッグサイト(南2ホール)

ブースNo. 12-20



基地局 / 通信機器の評価

Click

小型環境試験器 シールド仕様



温度範囲: -40℃～+100℃の卓上タイプでシールド機能を有した恒温器。省スペースで端末、エッジデバイスの高/低温動作試験や温度特性試験時のEMC対策に最適です。

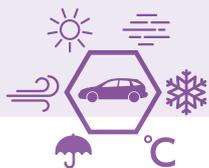
Click

電波暗箱型低温恒温器/恒温室

電波暗箱/室の機能と恒温槽/室の機能を兼ね備えた、電波無響環境下での温度環境試験が可能な複合環境試験器です。



車載センサー/カメラの評価



全天候型試験ラボ

温湿度範囲: -40℃～+80℃ / 10～95%rhの建屋タイプ。温湿度・気流・雨・霧・雪・太陽光を組み合わせ、動的気象環境下での評価試験が可能です。

Click

高周波 / 高耐熱のコンデンサ・インダクタ評価、実装評価

Click

低誘電材料/高耐圧絶縁評価システム

高温高湿環境と通電により絶縁不良を加速させ、抵抗値変化の測定により絶縁劣化を評価いたします。パソコンによる自動計測、データ収録およびデータ処理のシステム化によって、より正確な接続信頼性評価が可能です。



プリント実装基板/配線の評価

Click

スポット冷却加熱装置

試料を直接冷却・加熱し、チャンパーレスで温度特性評価が可能。温度変化速度100℃/分(空気温度)タイプを新たにラインアップしております。



Click

卓上型無風恒温槽

AC100Vで使用可能、屈折率の低い観測窓を採用した無風恒温槽。半導体や実装基板の温度特性評価・熱解析の検証に最適です。



Click

熱変形計測システム

3次元デジタル画像相関法(3D DIC)を組み合わせ、温度環境下における実装基板の反り変形量の可視化が可能。受託解析も承っております。



スライド扉式小型環境試験器

Click

卓上に設置可能なコンパクトサイズの恒温槽にスライド扉やインターフェイスの装備が可能です。配線距離の短縮が図れ、測定精度の向上、配線作業の簡易化などに優れた試験装置です。



5G/IoTウェビナー 公開中!

無料

視聴はこちらをクリック

5G・IoT Solution Expo ESPEC

●エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク 0120-701-678

Leaf No.20240402

エスペック株式会社 <https://www.espec.co.jp/>

本社 530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6